

EV、パワーデバイス、5G 技術と関連材料技術をご紹介します

技術部会

電気機能材料工業会技術部会主催による「電気・電子材料技術セミナー “Insulation 2019”」を「亀戸文化センター (カメラアプラザ)」において、2019年11月19日(火)に開催しました。会員の皆様の関心が高く参加者は合計98名(会員67名、協賛会員他26名、学生5名)でした。多忙なスケジュールの中、ご講演を頂いた各先生並びに参加された各位、及び参加を許可くださった各上司の皆様に、紙上を借りて心より御礼申し上げます。技術セミナーは、下記の特別講演4件と一般講演2件の構成であり、自動車のEV化、新しい通信技術5G、関連材料技術を取り込んだ、材料開発指針を示す講演としました。講演終了後、同センター大研修室にて、講師を囲んでの懇親会を開催しました。



(写真 貝塚氏 講演)



(写真 講演会の様子)



(写真 懇親会の様子)

講演は下記の通り

11月19日(火)

1. (特別講演)「ホンダ電動車用モータの開発と進化について」
株式会社本田技術研究所 貝塚 正明 氏
2. (特別講演)「新規なフレキシブル回路基板用耐熱樹脂 変性ポリイミド」
東邦大学理学部化学科 長谷川 匡俊 氏
3. (一般講演)「機能性エポキシ樹脂の開発動向」
三菱ケミカル株式会社 太田 員正 氏
4. (特別講演)「5G 実現に向けてのドコモの取り組みとさらなる発展に向けて」
株式会社 NTT ドコモ 須山 聡 氏
5. (特別講演)「パワー半導体デバイスの構造と放熱について」
足利大学 工学部 西 剛伺 氏
6. (一般講演)「EV車における放熱部材について」
デンカ株式会社 米村 直己 氏